

美日領袖峰會 聚焦半導體合作

資料蒐集：工商時報

為解決全球晶片短缺危機，美日兩國政府將在晶片零組件供應上展開合作！根據外媒報導，當日本首相菅義偉於 4 月 16 日訪美，與美國總統拜登舉行領袖峰會時，雙方可能將簽訂協議，確保半導體供應無虞。

菅義偉將是拜登入主白宮來首位造訪美國的國外領袖。這場領袖峰會原本預定在 4 月 9 日召開，不過後來卻因故推延到 16 日。

媒體指出，在 4 月召開的美日峰會上，兩國領袖將尋求建立分散式的供應鏈體制，以降低對某個特定區域的依賴，包括地緣政治風險高的台灣，以及與美國衝突日漸加劇的中國。

今年來半導體晶片嚴重缺貨，已使得全球多個產業陷入混亂，像是多家美日車廠被迫減產，另外部分大型消費電子製造商的營運也受到波及。

然而為避免晶片缺貨危機持續擴大，並將進一步衝擊國家經濟與安全，美日決策者正積極尋求化解晶片匱乏的因應對策。

例如拜登政府在日前公布的逾 2 兆美元基礎建設方案中，就計畫提撥 500 億美元支持半導體產業。在此之前，美國半導體大廠英特爾也宣布將砸下 200 億美元蓋新廠，重返晶圓代工領域。

白宮國家安全顧問蘇利文 (Jake Sullivan) 2 日則是先行與來訪的日本國家安全保障局長北村滋、韓國國家安室長徐薰就半導體與科技供應鏈等議題進行討論，這也是拜登上任後，第一次召開國安層級的三邊會談。

根據熟悉該會談的白宮官員透露，由於美日韓三國各自掌握未來半導體的多項關鍵製造技術，因此這場會議的聚焦主軸之一，將是確保這些敏感供應鏈的安全，並且共同捍衛半導體相關規範、標準以及後續發展。

白宮幕僚並計畫 12 日將與晶片及汽車相關業者會面，商討美國供應鏈的彈性。另外根據產業的消息來源指出，在美國設有生產設施的韓國三星電子也已受邀，將在 4 月稍後與白宮進行另一場會議，討論半導體短缺等議題。